

超配（维持）

全年利润端整体承压，23Q4 环比复苏明显

半导体行业 2023 年业绩预告总结

2024 年 2 月 26 日

投资要点：

刘梦麟

SAC 执业证书编号：

S0340521070002

电话：0769-22110619

邮箱：liumenglin@dgzq.com.cn

陈伟光

SAC 执业证书编号：

S0340520060001

电话：0769-22119430

邮箱：

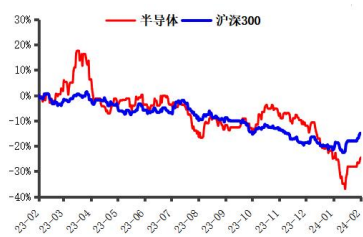
chenweiguang@dgzq.com.cn

■ **半导体板块整体业绩：受行业景气度影响，半导体利润端整体承压。**2023年，半导体行业整体处于“周期下行-底部复苏”阶段，智能手机、笔电等终端销售疲弱，导致上游半导体存储芯片、模拟芯片等零部件需求不振，行业景气承压。截至2024年1月31日，申万半导体151家企业中，共有95家披露2023年业绩预告&快报，占比62.91%，披露率高于A股市场整体水平；95家企业中，26家预计2023年业绩实现正向增长，占比27.37%，69家预计2023年业绩同比下降，占比72.63%。

■ **细分领域2023年业绩情况。**1) **半导体设备：国产替代持续推进，约七成设备企业23年业绩实现同比增长。**受益国内晶圆厂建厂潮兴起，以及国产半导体设备在内资晶圆厂中份额提升，半导体设备行业景气高企。已发布2023年业绩预告的半导体设备企业中，约七成企业全年业绩实现同比增长。分季度看，大多设备龙头企业23Q4归母净利润实现同比大幅增长，如北方华创、中微公司、拓荆科技等；2) **半导体材料：行业呈现去库存特征，全年业绩大多同比下滑。**相比半导体设备，半导体材料板块2023年业绩表现一般，主要原因为2023年全球半导体行业仍然呈现去库存特征，行业整体处于下行周期，对上游半导体材料的需求造成负面影响，此外，同业竞争加剧、国内产品导入进度较慢等因素，也导致国内半导体材料公司业绩承压。虽然进入2023年第四季度，电子终端需求已有复苏迹象，但行业库存调整仍在持续，有望在2024年迎来回暖；

(3) **半导体封测：行业产能利用率下滑，23Q4环比改善明显。**受半导体行业不景气的影响，大多半导体封测企业2023年业绩承压，营收、归母净利润同比下滑，且产能利用率在低位徘徊。分季度来看，通富微电、华天科技23Q4业绩环比增幅明显（按预告区间中值计算，下同），长电科技预计Q4营收环比实现小幅增长，甬矽电子预计23Q4实现扭亏为盈，表明行业正从底部逐步复苏；4) **分立器件：板块内部业绩分化，关注需求复苏与成本下降情况。**2023年分立器件、功率半导体企业整体业绩表现一般，主要原因为行业竞争加剧、下游消费&工业等需求萎靡，以及板块去库存的影响。2023年板块内企业业绩呈现较大分化，如宏微科技预计23年归母净利润同比增长约52%，士兰微、东微半导体和源杰科技预计2023年归母净利润同比下滑，但士兰微23Q4净利润预计实现环比大幅改善，实现扭亏为盈。在经历近两年降价与库存消化，板块库存趋于健康后，行业基本面已逐步好转。2024年1月，捷捷微电、深微半导体等部分厂商相继发布涨价函，后续关注下游市场复苏及上游原材料成本、产品生产成本的下降情况；5) **芯片设计：模拟、MCU等继续承压，存储、射频、CIS四季度环比改善。**2023年IC设计板块内细分领域业绩分化明显，受益下游消费类电子需求回温，叠加AI拉动存力需求，半导体存储、射频、CIS板块业绩修复较快，23Q4利润已实现环比改善，2024年有望继续复苏；而模拟芯片、MCU等整体延续疲软之势，市场现货充足，市况能见度较低，业内公司业绩承压；6) **晶圆代工：中芯国际全年利润大幅下滑，24年资本开支展望较为保守。**公司2023年营收表现符合预期，但利润下降幅度较大，主要原因为：下游市场需求疲软，行业库存较高导致去库存缓慢，且同业竞争激烈，集团平均产能利用率降低，晶圆销售数量减少。此外，集团处于高投入期，折旧较2022年增加，因此影响全年利润表现。从公司晶圆销售结构看，受益下游需求复苏，电脑&平板、智能手机Q4

半导体（申万）指数走势



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

相关报告

专题研究

行业研究

证券研究报告

本报告的风险等级为中高风险。

本报告的信息均来自已公开信息，关于信息的准确性与完整性，建议投资者谨慎判断，据此入市，风险自担。

请务必阅读末页声明。

占营收比重环比提高，表明下游厂商拉货效果显著；资本开支方面，公司预计2024年资本开支与23年相比大致持平，据中芯国际联席CEO赵海军表示，2024年芯片业会面临宏观经济、地缘政治、同业竞争和老产品库存的挑战，预计将出现量增价跌趋势，代工业利用率短期难以回升至前几年的高位水平。

- **投资建议：**建议从AI创新、周期复苏、和国产替代三方面把握半导体板块投资机遇。1) **AI创新：**关注数据中心硬件层面的AI芯片、服务器PCB、IC载板、DDR和先进封装等细分受益领域，此外可关注国产CPU/GPU等自主算力产业链相关企业；2) **周期复苏：**把握半导体封测、存储芯片、射频、CIS的复苏节奏与厂商库存情况；3) **国产替代：**随着内资晶圆厂产能持续扩张，叠加下游需求持续复苏，国内半导体设备&材料企业有望进一步深化国产替代进程，市场份额有望加速渗透，带来显著的订单增量。
- **风险提示：**终端复苏不及预期，国产替代不及预期，行业竞争加剧等。

目 录

1. 半导体行业 2023 年整体业绩：终端需求疲弱，利润端整体承压	5
2. 半导体设备：国产替代需求旺盛，设备龙头企业 23Q4 利润高速增长	5
部分企业业绩情况	6
3. 半导体材料：行业呈现去库存特征，企业业绩大多同比下滑	7
部分企业业绩情况	8
4. 半导体封测：行业产能利用率下滑，环比改善明显	9
部分企业业绩情况	10
5. 分立器件：板块内部业绩分化，关注产品放量情况	11
部分企业业绩情况	13
6. 芯片设计：模拟、MCU 等继续承压，存储、射频、CIS 四季度环比改善	14
部分企业业绩情况	15
7. 晶圆代工：中芯国际全年利润大幅下滑，24 年资本开支展望较为保守	19
8. 投资策略	21
9. 风险提示	22

插图目录

图 1：半导体行业 2023 年业绩预告披露情况	5
图 2：半导体行业 2023 年业绩预告同比变动情况	5
图 3：半导体设备行业 2023 年业绩预告披露情况	5
图 4：半导体设备行业 2023 年业绩预告同比变动情况	5
图 5：半导体材料行业 2023 年业绩预告披露情况	7
图 6：半导体材料行业 2023 年业绩预告同比变动情况	7
图 7：半导体封测行业 2023 年业绩预告披露情况	9
图 8：半导体封测行业 2023 年业绩预告同比变动情况	9
图 9：分立器件行业 2023 年业绩预告披露情况	11
图 10：分立器件行业 2023 年业绩预告同比变动情况	11
图 11：IC 设计行业 2023 年业绩预告披露情况	14
图 12：IC 设计行业 2023 年业绩预告同比变动情况	14
图 13：中芯国际单季度营业收入情况（2020Q1-2023Q4）	19
图 14：中芯国际单季度净利润情况（2020Q1-2023Q4）	19
图 15：中芯国际的单季度销售毛利率、净利率（2020Q1-2023Q4）	19
图 16：公司 23Q4 晶圆收入结构（以应用分类）	20
图 17：公司 23Q4 晶圆收入结构（以尺寸分类）	20
图 18：中芯国际的单季度产能利用率（2020Q1-2023Q4）	20

表格目录

表 1：部分半导体设备企业预告营收、归母净利润情况（所涉及金额均以预告区间中值为基准计算）	6
表 2：部分半导体材料企业预告营收、归母净利润情况（所涉及金额均以预告区间中值为基准计算）	8
表 3：部分集成电路封测企业预告营收、归母净利润情况（所涉及金额均以预告区间中值为基准计算）	10
表 4：部分分立器件企业预告营收、归母净利润情况（所涉及金额均以预告区间中值为基准计算）	11

表 5: 部分 IC 设计企业预告营收、归母净利润情况（所涉及金额均以预告区间中值为基准计算）	14
表 6: 重点公司盈利预测及投资评级（截至 2024/2/24）	21

1. 半导体行业 2023 年整体业绩：终端需求疲弱，利润端整体承压

终端需求疲弱，申万半导体 2023 年利润端整体承压。截至 2024 年 1 月 31 日，申万半导体 151 家企业中，共有 92 家企业披露 2023 年业绩预告，3 家企业披露 2023 年业绩快报，合计占比 62.91%。受全球电子行业景气度下行的影响，在这 95 家企业中，26 家预计 2023 年业绩实现同比增长（含利润增长/扭亏为盈/亏损收窄，下同），占比 27.37%，69 家预计 2023 年业绩同比下降（含利润收窄/由盈转亏/亏损扩大，下同），占比 72.63%。其中，除盛美上海业绩预告为营业收入（预计 2023 年实现营收 36.5 亿元至 42.5 亿元，同比增长 27.04%至 47.93%）外，其他企业预告内容均为净利润相关情况。

图 1：半导体行业 2023 年业绩预告披露情况

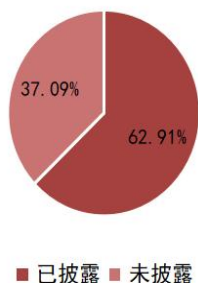
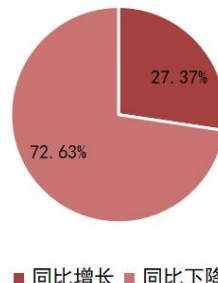


图 2：半导体行业 2023 年业绩预告同比变动情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

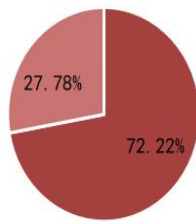
2. 半导体设备：国产替代需求旺盛，设备龙头企业 23Q4 利润高速增长

约七成半导体设备企业 2023 年业绩实现同比增长。截至 2024 年 1 月 31 日，申万半导体设备 18 家企有 13 家披露 2023 年业绩预告，占比 72.2%。13 家企业中，9 家预告 2023 年业绩实现同比增长，占比 69.23%，共有 4 家预计 2023 年业绩同比下跌，占比 30.77%。

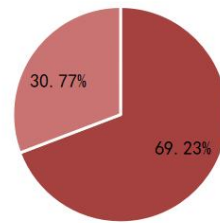
受益国产替代持续推进，国内龙头设备公司 23Q4 利润同比大幅增长。受益国内晶圆厂建厂潮兴起，以及国产半导体设备在内资晶圆厂中份额提升，大多半导体设备龙头企业在 23Q4 归母净利润实现同比大幅增长，如北方华创、中微公司、拓荆科技等。随着 2024 年大陆本土晶圆制造厂资本开支继续维持较高强度，以及半导体设备国产替代进程持续推进，国内半导体设备厂商业绩有望继续释放。

图 3：半导体设备行业 2023 年业绩预告披露情况

图 4：半导体设备行业 2023 年业绩预告同比变动情况



■ 已披露 ■ 未披露



■ 同比增长 ■ 同比下降

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

表 1：部分半导体设备企业预告营收、归母净利润情况（所涉及金额均以预告区间中值为基准计算）

股票代码	企业名称	23Q4 预告营收 (亿元)	23Q4 预告归母净利润 (亿元)	23Q4 营收同比	23Q4 归母净利润同比	23Q4 营收环比	23Q4 归母净利润环比
603690.SH	至纯科技	——	2.56	——	113.68%	——	193.05%
688200.SH	华峰测控	1.67	0.54	-42.95%	-62.53%	21.56%	51.57%
688072.SH	拓荆科技	9.97	3.89	39.70%	196.88%	42.74%	165.60%
688120.SH	华海清科	6.60	1.53	27.99%	-3.86%	8.89%	-19.63%
002371.SZ	北方华创	74.47	9.96	59.26%	49.38%	20.85%	-8.22%
688012.SH	中微公司	22.19	6.15	30.76%	63.25%	46.47%	292.16%
688082.SH	盛美上海	12.00	——	34.11%	——	5.28%	——

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

部分企业业绩情况

北方华创（002371）：公司于 1 月 15 日发布 2023 年度业绩预告，预计 2023 年实现营收 209.7 亿-231.0 亿元，同比增长 42.77%至 57.27%，归母净利润 36.1 亿-41.5 亿元，同比增长 53.44%至 76.39%，对应 Q4 营收为 63.82 亿元至 85.12 亿元，同比增长 36.48%至 82.04%，环比增长 3.57%至 38.14%，Q4 归母净利润为 7.26 亿元至 12.66 亿元，同比增长 8.87%至 89.88%，环比-33.11%至 16.66%。2023 年全年，公司主营业务发展态势良好，市场认可度不断提高，应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用，工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升；公司全年新签订单超过 300 亿元，其中集成电路领域占比超 70%，为中长期业绩增长贡献确定性。

中微公司（688012）：营收方面，公司预计 2023 年营业收入约 62.6 亿元，较 2022 年增加约 15.2 亿元，同比增长约 32.1%。2023 年新增订单金额约 83.6 亿元，较 2022 年增加约 20.4 亿元，同比增长约 32.3%，其中，公司的主打设备产品，用于集成电路生产线的 CCP 和 ICP 等离子体刻蚀设备预计 2023 年营业收入约 47.0 亿元，较 2022 年增加约 15.6 亿元，同比增长约 49.4%。2023 年新增刻蚀设备订单金额约 69.5 亿元，较 2022 年增加约 26.1 亿元，同比增长约 60.1%；净利润方面，公司预计 2023 年度实现归属于

母公司所有者的净利润为 17.00 亿元至 18.50 亿元，同比增加约 45.32%至 58.15%。若取预告区间中值，对应 23Q4 营收同比增长 30.76%，归母净利润同比增长 63.25%。

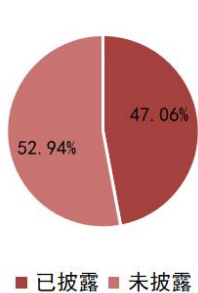
拓荆科技（688072）：公司预计 2023 年实现营业收入 260,000.00 万元至 280,000.00 万元，与上年同期相比增长 52.44%至 64.17%；预计公司 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 60,000.00 万元至 72,000.00 万元，与上年同期相比增长 62.81%至 95.38%；若取预告区间中值，对应 23Q4 营收同比增长 30.76%，归母净利润同比增长 63.25%。若取预告区间中值，对应 23Q4 营收同比增长 39.70%，归母净利润同比增长 196.88%。报告期内，公司在新工艺应用及新产品开发方面取得显著成效，PECVD 设备、ALD 设备、SACVD 设备持续拓展工艺，量产规模不断扩大，销售收入大幅度提升；HDPCVD 设备、混合键合设备表现出色，顺利通过客户端产业化验证，实现了产业化应用；客户拓展方面，报告期内，公司客户群体覆盖度进一步扩大，销售订单持续增长，2023 年年末在手销售订单金额超过 64 亿元（不含 Demo 订单），为后续业绩的增长提供保障。

3. 半导体材料：行业呈现去库存特征，企业业绩大多同比下滑

半导体材料；2023 年业绩表现承压，已披露业绩企业大多同比下滑。截至 2024 年 1 月 31 日，申万半导体材料 17 家企业中，有 8 家发布 2023 年全年业绩预告，占比 47.06%，其中 7 家企业 2023 年业绩预减，占比 87.5%。

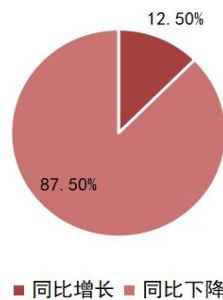
相比半导体设备，半导体材料板块 2023 年业绩表现一般，主要原因为 2023 年全球半导体行业仍然呈现去库存特征，行业整体处于下行周期，对上游半导体材料的需求造成负面影响，此外，同业竞争加剧、国内产品导入进度较慢等因素，也导致国内半导体材料公司业绩承压。虽然进入 2023 年第四季度，电子终端需求已有复苏迹象，但行业库存调整仍在持续，有望在 2024 年迎来回暖。

图 5：半导体材料行业 2023 年业绩预告披露情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 6：半导体材料行业 2023 年业绩预告同比变动情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

表 2：部分半导体材料企业预告营收、归母净利润情况（所涉及金额均以预告区间中值为基准计算）

股票代码	企业名称	23Q4 预告营收 (亿元)	23Q4 预告归母净利润 (亿元)	23Q4 营收同比	23Q4 归母净利润同比	23Q4 营收环比	23Q4 归母净利润环比
605358.SH	立昂微	6.77	-1.12	6.52%	-342.25%	0.99%	-1057.63%
300666.SZ	江丰电子	7.26	0.44	13.73%	5.34%	10.98%	10.11%
688234.SH	天岳先进	4.30	0.23	191.58%	-140.16%	11.24%	511.56%
688126.SH	沪硅产业	——	-0.28	——	-114.09%	——	-211.47%

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

部分企业业绩情况

立昂微（605358）：公司预计 2023 年度实现营业收入 269,000.00 万元左右，同比下降 7.7% 左右，预计实现归属于上市公司股东的净利润为 5,850.00 万元至 8,750.00 万元，同比下降 87.28% 至 91.49%，预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -12,500.00 万元至 -9,500.00 万元。若取预告区间中值，对应 23Q4 营收同比增长 6.52%，环比增长 0.99%，但归母净利润同比下滑 342.25%，实现由盈转亏。公司指出，报告期内半导体行业景气度下滑，市场需求疲软，公司部分产品销售订单有所减少，部分产品价格有所下调；除行业景气度下滑外，扩产、兼并收购和可转债等因素也拖累了公司整体业绩。

江丰电子（300666）：公司预计 2023 年实现营业收入约 25.78 亿元，较上年同期增长约 10.85%，预计 2023 年实现盈利 2.11 亿元至 2.64 亿元，相比上年同期下降 0% 至 20%。若取预告区间中值，则 23Q4 营收同比增长 13.73%，环比增长 10.98%，归母净利润同比增长 5.34%，环比增长 10.11%，业绩实现同比、环比改善。报告期内，管受到全球经济环境、半导体行业周期等影响，但公司始终积极扩大全球市场份额，营收规模实现增长；同时，公司持续加大研发投入，积极推进超高纯金属溅射靶材扩产项目，强化半导体精密零部件领域的战略布局，市场认可度不断提高。后续随着外围环境及行业周期好转，将有望加强公司的核心竞争力和盈利能力。目前，上述项目的扩产和推进，导致相应成本费用有所增加，同时受到产品销售结构变化、精密零部件和第三代半导体材料新品开发试制增加等多种因素影响，公司经营业绩较上年同期有所下降。

天岳先进（688234）：公司预计 2023 年年度实现营业收入 123,000.00 万元至 128,000.00 万元，同比增加 194.94% 到 206.93%；预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -5,400.00 万元至 -3,600.00 万元，与上年同期（调整后）相比，同比增加 69.30% 到 79.53%。若取预告区间中值，对应 23Q4 营收同比增长 191.58%，归母净利润实现同比扭亏。2023 年度，受益于碳化硅在下游新能源汽车、光伏发电、储能等应用领域的渗透应用，碳化硅半导体整体市场规模不断扩大。公司高品质碳化硅衬底获得了国内外客户的认可，并与下游电力电子、汽车电子领域的国内外知名企业开展了广泛合作，公司订单较上年增长。2023 年公司上海临港智慧工厂开启产品交付。2023 年公司导电型产品产能产量持续提升，产品交付能力增强，营业收入与上年同期相比增长较大。

沪硅产业（688126）：公司预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为

16,800.00 万元到 20,100.00 万元，同比下降 48.31%到 38.16%。归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润将出现亏损，为-18,000.00 万元到-14,400.00 万元，与上年同期相比将减少 29,524.88 万元到 25,924.88 万元。报告期内，公司经营业绩较 2022 年有较，大幅度的下降，主要是受市场影响和公司扩产项目持续投入的影响。

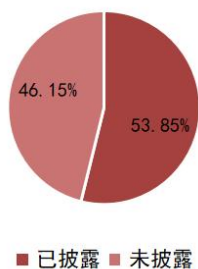
2023 年，公司拥有多个扩产项目，包括集成电路用 300mm 高端硅片扩产项目、300mm 高端硅基材料研发中试项目和 200mm 半导体特色硅片扩产项目均有序推进，其中集成电路用 300mm 高端硅片扩产项目到 2023 年底已释放 15 万片/月的新产能，合计产能达到 45 万片/月。扩产项目在实施过程中会产生一定前期费用同时增加较大的固定成本，对公司报告期内的经营业绩产生较大影响。

4. 半导体封测：行业产能利用率下滑，环比改善明显

半导体封测：行业产能利用率下滑，23Q4 环比改善明显。截至 2024 年 1 月 31 日，申万集成电路封测板块 13 家企业中，共有 7 家企业披露 2023 年业绩预告，占比 53.85%。其中，伟测科技预计 2023 年营收实现同比微幅增长（同比增长 0.47%左右），归母净利润实现同比下降（同比减少 50.68%左右），另外 6 家企业中，有 2 家企业 2023 年全年业绩实现同比增长，占比 33.33%，4 家企业预计 2023 年业绩同比下跌，占比 66.66%。

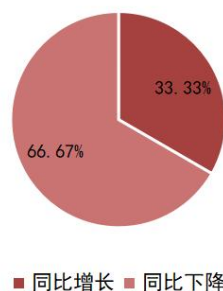
受半导体行业不景气的影响，大多半导体封测企业 2023 年业绩承压，营收、归母净利润同比下滑，分季度来看，通富微电、华天科技 23Q4 业绩环比增幅明显，长电科技预计 Q4 营收环比实现小幅增长，甬矽电子预计 23Q4 实现扭亏为盈，表明行业正从底部逐步复苏。

图 7：半导体封测行业 2023 年业绩预告披露情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 8：半导体封测行业 2023 年业绩预告同比变动情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

表 3：部分集成电路封测企业预告营收、归母净利润情况（所涉及金额均以预告区间中值为基准计算）

股票代码	企业名称	23Q4 预告营收（亿元）	23Q4 预告归母净利润（亿元）	23Q4 营收同比	23Q4 归母净利润同比	23Q4 营收环比	23Q4 归母净利润环比
002156.SZ	通富微电	——	2.19	——	766.10%	——	76.30%
688362.SH	甬矽电子	7.69	0.17	66.26%	-125.72%	18.58%	-142.51%
002185.SZ	华天科技	——	1.57	——	216.78%	——	685.89%
600584.SH	长电科技	——	4.95	——	-36.38%	——	3.61%

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

部分企业业绩情况

通富微电（002156）：公司预计 2023 年实现归母净利润 1.30 亿元至 1.80 亿元，同比下降 64.14%至 74.10%，若取预告区间中值，对应 23Q4 实现归母净利润 2.19 亿元，同比增长 766.10%，环比增长 76.30%。2023 年，公司立足市场最新技术前沿，努力克服传统业务不振及产品价格下降带来的不利影响，积极调整产品布局，在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长，积极推动 Chiplet 市场化应用，承接算力芯片订单，实现规模性量产。据公司财务部门初步统计，公司 2023 年营收呈现逐季走高趋势，且 2023 年下半年业绩较 2023 年上半年业绩大幅改善，扭亏为盈。公司紧紧围绕先进封装，在高性能计算、存储等领域不断加大研发投入和产能建设，未来业绩有望迎来新一轮增长。

长电科技（600584）：公司预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 13.22 亿元到 16.16 亿元，同比减少 49.99%到 59.08%，若取预告区间中值，对于 Q4 归母净利润同比下滑 36.38%，环比增长 3.61%。报告期内，全球终端市场需求疲软，半导体行业处于下行周期，导致客户需求下降，产能利用率降低。同时，受价格承压影响，整体利润下降。公司严格控制各项营运费用，抵消部分不利影响。从公司业绩预告情况来看，下半年相比上半年，业绩同比下降幅度有所减缓，下半年部分客户需求有所回升，四季度订单总额恢复到上年同期水平。

华天科技（002185）：公司预计 2023 年实现归母净利润 2.00 亿元至 2.80 亿元，相比上年同期下降 73.47%至 62.86%，若取预告区间中值，对应 23Q4 实现归母净利润 1.57 亿元，同比增长 216.78%，环比增长 685.89%受行业竞争加剧的影响，报告期内公司封装产品价格大幅下降，同时于公司规模不断扩大，折旧费用同比增加，导致公司 2023 年度止归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下滑。但从季度表现看，公司下半年客户需求有所回升，23Q4 净利润实现同比、环比改善。

甬矽电子（688362）：公司预计 2023 年年度实现营业收入 230,000.00 万元至 250,000.00 万元，同比增加 5.65%至 14.84%；并预计 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润 -12,000.00 万元到 -8,500.00 万元，同比减少 161.54%至 186.87%。若取预告区间中值，对应 23Q4 实现营收 7.69 亿元，同比增加 66.26%，环比增加 18.58%，23Q4 实现归母净利润 0.17 亿元，同比、环比实现扭亏为盈。一方面，报告期内下游需求复苏不及预期，公司所处的封测环节亦受到一定影响，整体价格承受一定压力；此外，公司二期项目陆

续投产，产能爬坡过程中人员、能源动力、固定资产折旧等固定支出较高。上述情况综合导致公司本报告期毛利率有所下滑。同时，新工厂建设及人员规模增加导致本期财务费用及管理费用亦有所上升，导致本年度整体净利润水平下滑；另一方面，公司通过通过增强新客户拓展力度、加强新产品导入力度、降低产品成本等多种方式，提升客户满意度和自身竞争力，客户群有效扩大，公司稼动率整体呈稳定回升趋势，营业收入规模逐季环比上升，且 23Q4 净利润实现扭亏为盈。

5. 分立器件：板块内部业绩分化，关注产品放量情况

分立器件：板块内部业绩分化，关注产品放量情况。截至 2024 年 1 月 31 日，申万半导体分立器件板块 19 家企业中，共有 9 家企业披露 2023 年业绩预告，占比 47.37%。其中，有 3 家企业 2023 年全年业绩实现同比增长，占比 33.33%，有 6 家企业预计 2023 年业绩同比下跌，占比 66.66%。

板块内部业绩分化，关注需求复苏与成本下降情况。2023 年分立器件、功率半导体企业整体业绩表现一般，主要原因为行业竞争加剧、下游消费&工业等需求萎靡，以及板块去库存的影响。2023 年板块内企业业绩呈现较大分化，如宏微科技预计 23 年归母净利润同比增长约 52%，士兰微、东微半导体和源杰科技预计 2023 年归母净利润同比下滑，但士兰微 23Q4 净利润预计实现环比大幅改善，实现扭亏为盈。在经历近两年降价与库存消化，板块库存趋于健康后，行业基本面已逐步好转。2024 年 1 月，捷捷微电、深微半导体等部分厂商相继发布涨价函，后续关注下游市场复苏及上游原材料成本、产品生产成本的下降情况

图 9：分立器件行业 2023 年业绩预告披露情况

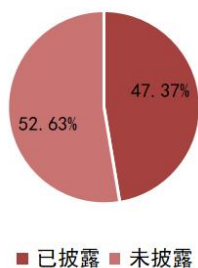
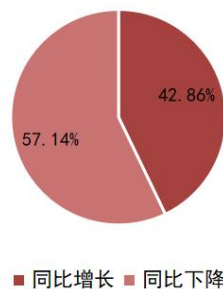


图 10：分立器件行业 2023 年业绩预告同比变动情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

表 4：部分分立器件企业预告营收、归母净利润情况（所涉及金额均以预告区间中值为基准计算）

股票代码	企业名称	23Q4 预告营收 (亿元)	23Q4 预告归母净利润 (亿元)	23Q4 营收同比	23Q4 归母净利润同比	23Q4 营收环比	23Q4 归母净利润环比
600460.SH	士兰微	---	1.46	---	-47.58%	---	-198.46%
688048.SH	长光华芯	0.76	-0.65	11.39%	-364.86%	-1.70%	450.71%
688261.SH	东微半导	---	0.09	---	-88.91%	---	-70.31%

688498.SH	源杰科技	---	0.01	---	-97.91%	---	-73.16%
688711.SH	宏微科技	---	0.34	---	97.27%	---	49.45%

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

部分企业业绩情况

士兰微（600460）：公司预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-5,200 万元到-3,500 万元，与上年同期相比，将出现亏损，若取预告区间中值，对应 23Q4 实现归母净利润 1.46 亿元，环比实现扭亏为盈。报告期内，公司持有的其他非流动金融资产中昱能科技、安路科技股票价格下跌，导致其公允价值变动产生的税后净收益为-45,227 万元，为公司业绩亏损的主要原因；此外，报告期内下游普通消费电子市场景气度相对较低，造成公司部分消费类产品出货量明显减少、其价格也有一定幅度的回落，对公司的销售和利润增长造成一定压力。对此，公司加大了模拟电路、IGBT 器件、IPM 智能功率模块、PIM 功率模块、碳化硅功率模块、超结 MOSFET 器件、MCU 电路、化合物芯片和器件等产品在大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等高端市场的推广力度，公司总体营收较上年同期增长约 13%。

长光华芯（688048）：公司预计 2023 年度实现营业收入人民币 26,894.00 万元到 32,156.00 万元，同比减少 16.61% 到 30.25%；预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，同比减少 166.42%到 179.40%；若取预告期间中值，则 23Q4 营收为 0.76 亿元，同比增长 11.39%，环比下降 1.70%，实现归母净利润-0.65 亿元，实现由盈转亏。报告期内，受宏观经济环境等因素的影响，市场信心不足，激光器市场需求持续疲软，同时行业竞争加剧，公司于 2023 年年初对价格策略进行了调整，上述因素导致公司毛利水平下降。另外，公司存货水平较高，部分存货出现减值现象，相应的资产减值准备计提影响了利润。

东微半导（688261）：公司预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 13,100.00 万元到 15,100.00 万元，同比下降 46.90%到 53.93%。若取预告期间中值，则 23Q4 归母净利润为 0.09 亿元，同比下降 88.91%，环比下降 70.31%。报告期内，受全球经济增速下行以及竞争格局加剧等多重因素的影响，公司产品销售价格和毛利率有所下降。同时，公司积极优化产品组合策略，进行工艺平台迭代升级，继续保持主要产品销量的上升，但由于产品销售价格的下降，致使公司报告期内营业收入较 2022 年同期出现下滑。此外，报告期内，公司进一步加大前瞻性研发投入力度，相应的材料、职工薪酬、研发设备及平台开发等研发投入均持续增长，亦对公司报告期经营业绩产生影响。

源杰科技（688498）：公司预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 1,800 万元到 2,600 万元，同比减少 74.08%到 82.06%，若取预告期间中值，则 23Q4 归母净利润为 0.01 亿元，同比减少 97.91%，环比减少 73.16%。报告期内，电信市场受到下游客户库存及终端运营商建设节奏放缓的影响，销售额大幅下滑，同时国内市场部分产品价格竞争日益激烈，以及销售的产品结构发生了变化，造成了毛利率水平有所下降；数据中心方面，传统的云数据中心在经过几年较大规模的投资后，2023 年出现较为明显的放缓和下滑，此外，报告期内，公司对可能发生减值的资产计提了相应的减值准备，也影响了当期业绩表现。

宏微科技（688711）：公司预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 11,000.00 万元至 13,000.00 万元，同比增长 39.76%至 65.17%。若取预告期间中值，对

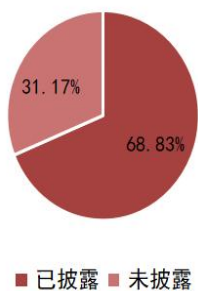
应 23Q4 实现归母净利润 0.34 亿元，同比增长 97.27%，环比增长 49.45%。报告期内，公司强化与各领域核心客户的合作关系，进一步聚焦重点应用领域、重点客户和重点产品。以客户订单及份额的大幅度增长带动公司的高速成长。其中，光伏领域销售收入增长 100%以上，电动汽车领域销售收入增长 80%以上，工控领域销售收入增长 20%以上；产能方面，公司模块封测产能稳步提升，截止到 2023 年末，车规级 IGBT 产线实现全自动化生产，月产能达 10 万只；光伏 IGBT 模块生产专线投产，月产能达 20 万只；业务布局方面，报告期内公司设立子公司常州芯动能半导体有限公司，聚焦塑封模块，双面和单面散热塑封模块深入布局，拓宽宏微产品型号及在电动汽车等领域的应用范围。

6. 芯片设计：模拟、MCU 等继续承压，存储、射频、CIS 四季度环比改善

芯片设计：模拟、MCU 等继续承压，存储、射频、CIS 四季度环比改善。截至 2024 年 1 月 31 日，A 股芯片设计（含模拟芯片设计、数字芯片设计）的 77 家企业中，共有 53 家披露 2023 年业绩预告，占比 68.83%，其中，有 12 家企业 2023 年全年业绩实现同比增长，占比 22.64%，有 41 家企业预计 2023 年业绩同比下跌，占比 77.36%。

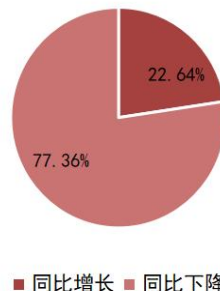
从已披露业绩情况来看，2023 年 IC 设计板块内细分领域业绩分化明显，受益下游消费类电子需求回温，叠加 AI 拉动存力需求，半导体存储、射频、CIS 板块业绩修复较快，23Q4 利润已实现环比改善，2024 年有望继续复苏；而模拟芯片、MCU 等整体延续疲软之势，市场现货充足，市况能见度较低，业内公司业绩承压。

图 11：IC 设计行业 2023 年业绩预告披露情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 12：IC 设计行业 2023 年业绩预告同比变动情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

表 5：部分 IC 设计企业预告营收、归母净利润情况（所涉及金额均以预告区间中值为基准计算）

股票代码	企业名称	23Q4 预告营收 (亿元)	23Q4 预告归母净利润 (亿元)	23Q4 营收同比	23Q4 归母净利润同比	23Q4 营收环比	23Q4 归母净利润环比
688536.SH	思瑞浦	2.74	-0.49	-12.84%	386.39%	36.35%	-2324.25%
300661.SZ	圣邦股份	—	1.55	—	26.12%	—	195.77%
603160.SH	汇顶科技	12.09	1.45	40.01%	-122.30%	2.89%	-2.61%

688798.SH	艾为电子	7.47	1.56	78.11%	-244.18%	-3.51%	-505.74%
300782.SZ	卓胜微	13.20	3.05	99.73%	261.44%	-6.27%	-32.68%
688153.SH	唯捷创芯	13.39	1.08	162.43%	-2588.72%	86.10%	86.40%
688521.SH	芯原股份	---	-1.51	---	-467.40%	---	-3.61%
688595.SH	芯海科技	1.49	-0.55	13.03%	13418.47%	18.29%	205.04%
688728.SH	格科微	14.05	0.10	2.34%	-108.81%	8.67%	-85.84%
688213.SH	思特威	---	0.79	---	-292.20%	---	9037.36%
688525.SH	佰维存储	14.78	-1.16	84.61%	2304.28%	51.67%	-38.15%
688008.SH	澜起科技	7.55	2.31	-4.62%	-23.03%	26.32%	52.23%
688123.SH	聚辰股份	---	0.17	---	-82.62%	---	-12.06%
300223.SZ	北京君正	---	1.42	---	147.31%	---	-2.76%
603986.SH	兆易创新	13.72	-2.79	0.78%	608.28%	-4.00%	-385.25%
301308.SZ	江波龙	36.71	0.53	115.65%	-138.70%	27.84%	-118.41%
300327.SZ	中颖电子	---	0.83	---	568.90%	---	494.88%
688041.SH	海光信息	20.69	3.6	58.54%	138.41%	55.44%	60.71%

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

注：海光信息已发布 2023 年业绩快报，采用业绩快报值进行计算

部分企业业绩情况

模拟芯片：

思瑞浦(688536)：公司预计 2023 年年度实现营业收入为 108,000.00 万元到 109,500.00 万元，同比减少 39.44%到 38.60%，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 -3,600.00 万元到-3,000.00 万元。若取预告区间中值，对应 23Q4 实现营收 2.74 亿元，同比下降 12.84%，环比增长 36.35%，对应 23Q4 归母净利润为-0.49 亿元，环比由盈转亏。报告期内，受经济形势、行业景气周期、客户去库存等因素影响，通讯、工业等终端市场需求未见明显复苏，公司整体营业收入较去年同期下降；且报告期内市场竞争激烈，公司部分产品销售价格承压，部分产品毛利率下降，报告期公司综合毛利率预计在 52%左右。此外，为坚定推进平台化业务布局，促进公司可持续发展，公司持续加强车规级产品及数据转换器、接口、电源、MCU 等产品的研发及技术投入，并推进海内外市场开拓，研发、销售人员数量增加，职工薪酬、研发材料及测试费、折旧摊销等较上年同期增加。

圣邦股份(300661)：公司预计 2023 年实现归母净利润 2.62 亿元至 3.32 亿元，同比下降 62.0%至 70.0%，若取预告区间中值，对应 23Q4 实现归母净利润 1.55 亿元，同比增长 26.12%，环比增长 195.77%。报告期内受行业景气度影响，公司 2023 年全年业绩承压，归母净利润同比大幅下滑，但随着下游模拟芯片需求逐步复苏，公司 23Q4 利润表现出现明显改善，下半年经营业绩明显好于上半年。

汇顶科技(603160)：公司预计 2023 年年度实现营业收入 440,500 万元左右，同比增长 30.2%左右，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 13,200 万元到 18,200 万元。若取预告区间中值，对应 23Q4 营收为 12.09 亿元，同比增长 40.01%，

环比增长 2.89%，对应 23Q4 归母净利润为 1.45 亿元，同比实现扭亏为盈，环比下滑 2.61%。报告期内，受终端客户需求增加及库存结构调整影响，外加 OLED 软屏的加速渗透，公司指纹、触控产品依托产品优势实现市场份额的进一步提升，同比上年同期出货量实现大幅增长，库存大幅降低，收入实现同比增长 30.2% 左右；此外，结合市场需求及自身实际情况，公司调整和优化了相关研发项目，合理分配研发资源并积极提升研发效率，成效明显；同时，公司加强管控销售费用和管理费用，2023 年公司销管研费用合计金额同比减少约 53,800 万元，同比下降 26.5% 左右。

CIS:

格科微（688728）：公司预计 2023 年年度实现营业收入 420,000.00 万元到 510,000.00 万元，同比减少 14.20% 至 29.34%。预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 4,800.00 万元到 7,200.00 万元，同比减少 83.59% 到 89.06%；若取预告区间中值，对应 23Q4 营收为 14.05 亿元，同比增长 2.34%，环比增长 8.67%，对应 23Q4 归母净利润为 0.10 亿元，同比实现扭亏为盈，环比下降 85.84%。报告期内，受到地缘政治、全球通胀等多重因素影响，消费电子市场需求放缓，手机行业景气度降低。公司具有传统优势的 200-800 万像素产品出货量减少；公司独有的高像素单芯片集成技术研发成功，自 2023 年 9 月起，1,300 万及 3,200 万像素产品已逐步实现量产，5,000 万像素产品亦实现小批量出货，1,300 万像素及以上产品出货量稳步上升，但作为新进入者，公司在定价策略上有所控制，毛利率因此下降。

思特威（688213）：公司预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润将实现扭亏为盈，实现归属于母公司所有者的净利润为 1,100 万元到 1,600 万元。与上年同期相比，将增加 9,375 万元到 9,875 万元。若按预告区间中值计算，公司 23Q4 归母净利润为 0.79 亿元，同比实现扭亏为盈，环比大幅增长 9037.36%。报告期内，公司在消费电子领域与现有客户在中低阶产品领域的合作不断深入，市场占有率持续提升；同时高阶 5000 万像素产品量产出货顺利，该类产品主要应用于高端旗舰手机的主摄、广角、长焦等摄像头，且单价较高，为公司的消费电子领域营收开辟出第二条增长曲线。在应用于机器视觉的智慧安防领域，公司发布多颗专业级 CIS 产品，产品矩阵的不断扩展支撑公司机器视觉业务呈现出强劲增长态势。

射频芯片:

卓胜微（300782）：公司公司预计 2023 年度实现营业收入 43.94 亿元，较去年同期增长约 19.50%，预计 2023 年实现归母净利润 10.80 亿元至 11.67 亿元，同比增长 1.01% 至 9.15%，若取预告区间中值，对应 23Q4 营收为 13.20 亿元，同比增长 261.44%，环比下降 6.27%，对应 23Q4 归母净利润为 3.05 亿元，同比增长 261.44%，环比下降 32.68%。2023 年度，虽然上半年全球经济增速放缓使得公司主要下游应用智能手机市场需求疲软，但是下半年受益于节假日消费刺激传导和客户库存结构逐步优化，下游客户需求有所增长。报告期内，公司聚焦自建滤波器产线，在推动有序规模量产的基础上，加快产品的迭代升级速度，响应客户多样化需求，不断深化射频滤波器模组产品的市场覆，下半年业绩实现明显改善。

唯捷创芯(688153): 公司预计 2023 年实现营业收入 29.5 亿元左右, 同比增长约 28.8%。预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 9,500.00 万元左右, 同比增长约 77.93%, 对应 23Q4 营收为 13.39 亿元, 同比增长 162.43%, 环比增长 86.10%, 对应 23Q4 归母净利润 1.08 亿元, 同比实现扭亏为盈, 环比增长 86.40%。报告期内, 公司新产品高集成度模组 L-PAMiD 凭借其卓越的性能, 迅速实现了市场突破和销售增长。目前已导入国内多家品牌手机客户, 实现了大规模量产出货, 带动了公司 2023 年营业收入和净利润的双增长; 公司 Wi-Fi 产品市场规模迅速扩大, 在 2023 年实现了营业收入和利润的大幅增长。目前该产品的销售以 Wi-Fi6 与 Wi-Fi6E 为主, Wi-Fi7 产品也已正式推出并实现量产销售; 充满挑战与机遇的市场环境中, 公司积极响应市场需求, 持续优化产品组合。截至报告期末, 公司在 5G 产品领域的营业收入稳步上升, 已占 PA 类产品营收的 50%以上。

存储芯片:

佰维存储(688525): 公司预计 2023 年度实现营业收入为 35-37 亿元, 同比增长 20%-22%, 预计 2023 年将出现亏损, 实现归属于母公司所有者的净利润-65,000.00 万元到 -55,000.00 万元, 按预告区间中值计算, 对应 23Q4 营收为 14.78 亿元, 同比增长 84.61%, 环比增长 51.67%, 对应 23Q4 归母净利润为-1.16 亿元。2023 年, 在全球经济低迷和行业周期下行的压力下, 终端市场需求持续疲软, 以智能手机、PC、服务器等为代表的存储市场需求持续萎缩, 导致存储器出货量及价格大幅下滑, 据 Gartner 报告显示, 2023 年全球存储器市场规模下降了 37%, 成为半导体市场中下降最大的细分领域。国内外存储产业均承受巨大的经营压力, 龙头企业(如三星存储、海力士、美光等)均出现明显亏损。在此情况下, 公司 2023 年毛利率预计下滑超过 10 个百分点, 受行业整体下行等因素的影响, 存储产品售价大幅下降, 基于谨慎性原则, 公司预计 2023 年存货跌价准备余额新增约 1.39 亿元, 对公司业绩造成不利影响; 2023 年四季度以来, 存储器市场出现复苏, 手机等领域需求有所恢复, 公司积极拓展国内外一线客户, 2023 年 Q4 预计实现营业收入 14-16 亿元, 同比增长超过 80%, 环比增长超过 50%; 毛利率环比回升超过 13 个百分点。公司四季度业绩亏损主要受股份支付、存货减值等影响。

澜起科技(688008): 公司预计 2023 年度实现营业收入 22.7 亿元至 22.9 亿元, 较上年同期减少 37.6%至 38.2%, 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 4.4 亿元至 4.9 亿元, 较上年同期减少 62.3%至 66.1%, 按预告区间中值计算, 对应 23Q4 营收为 7.55 亿元, 同比下降 4.62%, 环比增长 26.32%, 对于国内 23Q4 归母净利润为 2.31 亿元, 同比下降 23.03%, 环比增长 52.23%。受全球服务器及计算机行业需求下滑导致的客户去库存影响, 2023 年公司 DDR4 内存接口芯片与津逮®CPU 出货量较上年同期有所减少, 因此公司营业收入较上年同期下降。净利润下降的主要原因包括: (1) 营业收入较上年同期减少; (2) 投资收益及公允价值变动收益总额较上年同期大幅减少; (3) 公司保持高强度研发投入, 研发费用较上年同期增加; (4) 公司计提的资产减值损失较上年同期增加。2023 年第四季度, 随着 DDR5 内存接口芯片(特别是第二子代产品)及内存模组配套芯片出货量进一步提升, 公司主要经营指标环比持续改善。

聚辰股份(688123): 公司预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 9,500.00

万元到 10,300.00 万元，同比减少 73.15%到 70.89%，按预告区间中值计算，对应 23Q4 归母净利润为 0.17 亿元，同比、环比下滑幅度分别为 82.62%、12.06%。受全球宏观经济下行、地缘政治局势紧张、终端消费电子行业景气度下滑以及下游模组厂商的采购及库存策略调整等因素影响，公司部分业务的发展承受了较大压力。具体到主要产品而言，个人电脑及服务器市场需求的疲软，使得全球主要内存模组厂商通过暂停采购和削减产能等方式减轻库存压力，导致报告期内公司 SPD 产品的销量及收入较上年同期出现较大幅度下滑，成为影响公司业绩下滑的主要因素。随着下游内存模组厂商库存水位的逐步改善，以及 DDR5 内存模组的渗透率持续提升，公司第四季度特别是 12 月份的 SPD 产品销量及收入环比实现较大幅度增长，相关业务回暖趋势明显。

兆易创新（603986）：公司预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 15,500 万元左右，与上年同期相比减少 189,757 万元左右，同比降幅 92.45%左右；预计 2023 年度实现营业收入 57.66 亿元左右，与上年同期相比减少 23.64 亿元左右，同比下降 29.08%左右；对应 23Q4 营收为 13.72 亿元，同比增长 0.78%，环比下降 4.00%，对应 Q4 归母净利润为-2.79 亿元，环比由盈转亏。受全球经济环境、行业周期等影响，2023 年公司所处半导体行业仍面临需求复苏缓慢的严峻考验，同时行业竞争激烈，导致公司产品销售价格和毛利率下滑明显。公司努力开拓市场，产品出货量同比增加，但由于产品价格大幅下降，2023 年度公司营业收入、毛利出现下滑；此外本年度公司计提资产减值损失，全年商誉、存货等资产减值损失预计 6.12 亿元左右。其中商誉减值损失预计 3.8 亿元左右，存货减值损失预计 2.32 亿元左右，对业绩造成不利影响。

其他（AI 相关）：

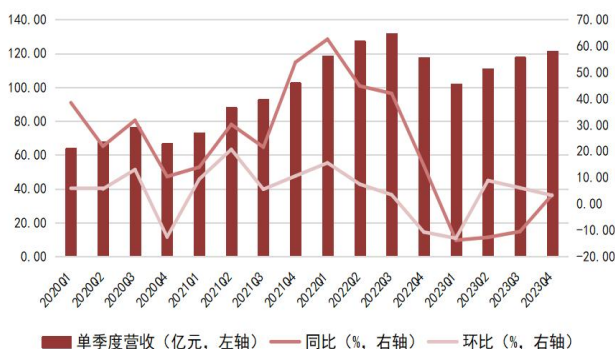
海光信息（688041）（CPU, DCU）：公司预计 2023 年年度实现营业收入 568,000.00 万元到 626,000.00 万元，同比增长 10.82%到 22.14%，预计 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润 118,000.00 万元到 132,000.00 万元，同比增长 46.85%到 64.27%。按预告区间中值计算，对应 23Q4 营收为 20.27 亿元，同比增长 55.30%，环比增长 52.31%，对应 23Q4 归母净利润为 3.48 亿元，同比增长 130.04%，环比增长 55.39%。报告期内，公司始终围绕通用计算市场，保持着高强度的研发投入，通过技术创新、产品迭代、性能提升等举措，不断增强产品竞争优势，在收入、毛利率方面持续提升，进一步夯实了公司的领先优势和市场竞争力，实现了业绩的持续增长。

芯原股份（688521）（半导体 IP）：公司预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-29,800.00 万元至-27,200.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比下降 34,581.43 万元至 37,181.43 万元。2023 年度，全球半导体产业面临严峻挑战，整体市场需求放缓，公司预计营业收入同比有所下降。公司所处的集成电路行业为高技术密集型行业，公司坚持高研发投入以保持技术先进性，2023 年度持续深化面向 AIGC、自动驾驶等多个领域的研发布局，推进半导体 IP 和 Chiplet 等技术的研发工作，研发人力成本同比有所增长。此外，本着谨慎性原则，公司对应收款项余额的客户进行了风险识别，并根据不同风险组合相应计提了信用减值损失准备。上述原因构成公司本期业绩变化的主要原因。

7. 晶圆代工：中芯国际全年利润大幅下滑，24 年资本开支展望较为保守

中芯国际 23Q4 营收实现同比、环比增长，但受行业景气度影响，全年利润下滑幅度较大。2023 年第四季度，中芯国际的销售收入为 16.783 亿美元，环比增长 3.6%，同比增长 3.5%，略高于指引；毛利率方面，公司 23Q4 毛利率为 16.4%，符合指引；公司 2023 年度未经审计的营业收入为人民币 45,250.4 百万元，同比下降 8.6%；2023 年度未经审计的归属于上市公司股东的净利润为人民币 4,822.8 百万元，上年归属于上市公司股东的净利润为人民币 12,133.1 百万元，同比下降 60.3%。公司 2023 年营收表现符合预期，但利润下降幅度较大，主要原因为：下游市场需求疲软，行业库存较高，去库存缓慢，且同业竞争激烈，集团平均产能利用率降低，晶圆销售数量减少。此外，集团处于高投入期，折旧较 2022 年增加，因此影响全年利润表现。

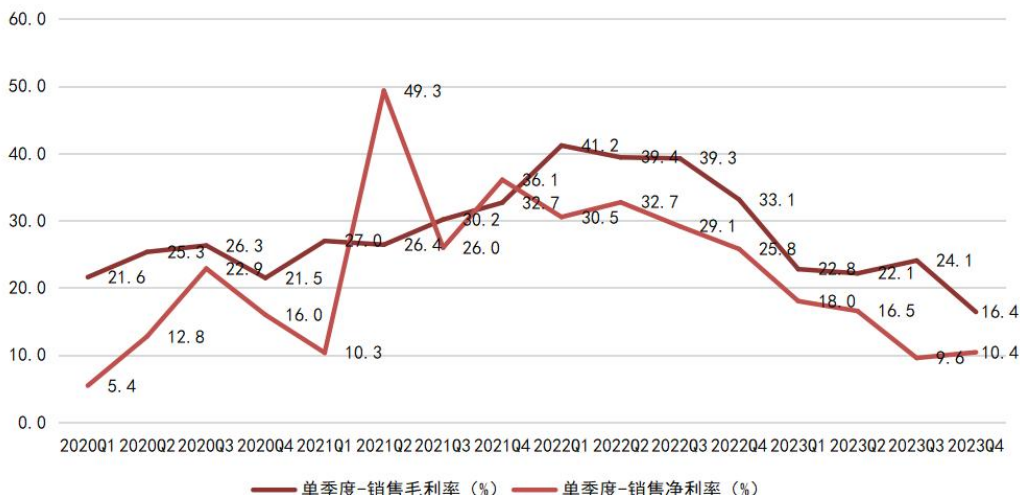
图 13：中芯国际单季度营业收入情况（2020Q1-2023Q4） 图 14：中芯国际单季度净利润情况（2020Q1-2023Q4）



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 15：中芯国际的单季度销售毛利率、净利率（2020Q1-2023Q4）



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

应用占比分析：受益下游需求复苏，智能手机、PC&平板占比提升。从 23Q4 开始，公司对下游应用类型做了更详细的拆分，从公司应用占比看，电脑&平板、智能手机依然是公司前两大营收贡献来源，营收占比分别为 30.6%、30.2%，环比 2023 年第三季度分别提高 1.4 和 4.3 个百分点，相比 22Q4 分别提升 10.7 和 1.6 个百分点。进入 2023 年以来，智能手机、PC 终端企业持续推进库存去化且成效显著，进入 2023 年下半年，华为、小米等新机陆续发布推动智能手机市场出货回升，叠加终端厂商预热 AI PC 拉动行业备货潮，因此公司智能手机、PC 业务有所回暖，占比持续提升。

图 16：公司 23Q4 晶圆收入结构（以应用分类）

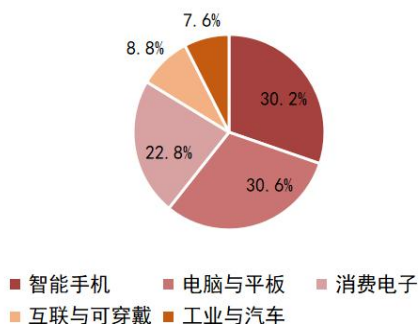
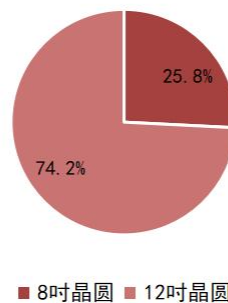


图 17：公司 23Q4 晶圆收入结构（以尺寸分类）

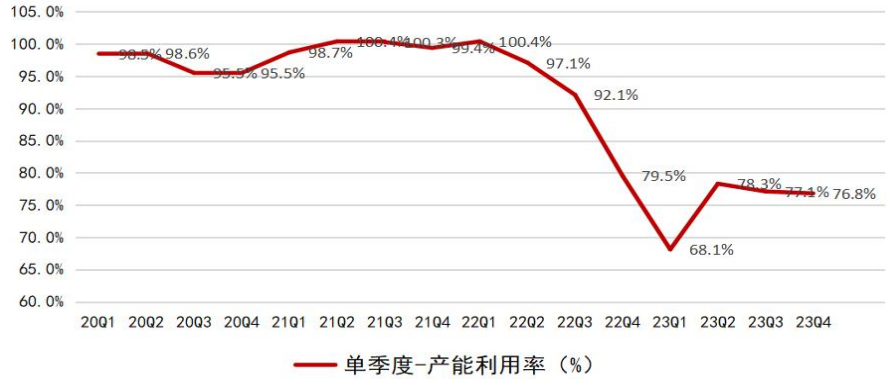


资料来源：中芯国际，东莞证券研究所

资料来源：中芯国际，东莞证券研究所

公司预计 24 年资本开支与 23 年大致持平，Q1 营收将实现环比小幅增长。资本开支方面，公司 2023 年第四季度资本开支为 23.409 亿美元，单季度产能利用率为 76.8%，环比下降 0.3 个百分点，2023 年全年资本开支约为 74.7 亿美元，符合此前指引（75 亿美元左右）。公司预计 2024 年资本开支与 23 年相比大致持平，且预计 24 年全年收入增幅不低于同业平均值，约实现个位数左右增长。展望 24Q1，公司预计营收、净利润环比增幅均为 2% 左右，毛利率介于 9%—11% 之间。据中芯国际联席 CEO 赵海军表示，2024 年芯片业会面临宏观经济、地缘政治、同业竞争和老产品库存的挑战，预计将出现量增价跌趋势，代工业利用率短期难以回升至前几年的高位水平。

图 18：中芯国际的单季度产能利用率（2020Q1-2023Q4）



资料来源：中芯国际，东莞证券研究所

8. 投资策略

维持对半导体行业超配评级。 半导体板块 2023 年利润端整体承压，但板块内部业绩分化较为明显，一方面，受益半导体核心领域国产化率提升，国内半导体设备板块表现相对亮眼，如北方华创、中微公司等设备龙头预计全年业绩实现高速增长；另一方面，受益下游消费类电子需求回温，叠加 AI 拉动存力需求，半导体封测、存储、射频、CIS 等细分领域虽然全年利润同比下滑，但 Q4 业绩已实现明显修复，板块触底信号明显；而模拟芯片、MCU 等整体延续疲软之势，当前市场能见度仍然较低，静待企业拐点显现。

投资方面，建议从 AI 创新、周期复苏、和国产替代三方面把握半导体板块投资机遇，1) **AI 创新**：关注数据中心硬件层面的 AI 芯片、服务器 PCB、IC 载板、DDR 和先进封装等细分受益领域，此外可关注国产 CPU/GPU 等自主算力产业链相关企业；2) **周期复苏**：把握半导体封测、存储芯片、射频、CIS 的复苏节奏与厂商库存情况；3) **国产替代**：随着内资晶圆厂产能持续扩张，叠加下游需求持续复苏，国内半导体设备&材料企业有望进一步深化国产替代进程，市场份额有望加速渗透，带来显著的订单增量。

建议关注标的：

半导体设备与材料：北方华创（002371）、中微公司（688012）、鼎龙股份（300054）、江丰电子（300666）；

存储芯片：兆易创新（603986）、澜起科技（688008）；

先进封装：长电科技（600584）、通富微电（002156）；

射频&CIS：卓胜微（300782）、韦尔股份（603501）、思特威（688213）；

算力芯片：海光信息（688041）

表 6：重点公司盈利预测及投资评级（截至 2024/2/24）

股票代码	股票名称	股价 (元)	EPS (元)			PE (倍)			评级	评级变动
			2022A	2023E	2024E	2022A	2023E	2024E		

002371	北方华创	261.66	4.45	7.06	9.72	135	37	27	买入	维持
688012	中微公司	130.58	1.90	2.72	3.15	71	48	41	买入	维持
300054	鼎龙股份	20.01	0.41	0.33	0.50	89	61	40	买入	维持
300666	江丰电子	45.04	1.11	1.05	1.47	580	43	31	买入	维持
603986	兆易创新	71.98	3.09	0.97	2.12	57	74	34	买入	维持
688008	澜起科技	51.61	1.15	0.43	1.20	58	119	43	买入	维持
600584	长电科技	25.13	1.81	0.99	1.63	59	25	15	买入	维持
002156	通富微电	21.50	0.37	0.15	0.61	60	139	35	买入	维持
300782	卓胜微	98.14	2.00	2.23	2.96	61	44	33	买入	维持
603501	韦尔股份	87.27	0.84	0.83	2.19	62	106	40	买入	维持
688213	思特威	42.60	-0.22	0.18	0.73	64	237	59	买入	首次
688041	海光信息	81.40	0.38	0.54	0.73	65	151	112	买入	首次

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

注：除海光信息 2023 年 EPS 为实际值外，其他公司 2023/2024 年 EPS 用同花顺一致预测值

9. 风险提示

(1) 终端复苏不及预期：半导体行业当前正处于逐步复苏期，若终端需求复苏力度不及预期，则可能对相关上市公司业绩造成不利影响

(2) 国产替代不及预期：半导体设备与材料、高端被动元器件等领域的国产替代是大势所趋，若产业链公司技术突破不如预期导致国产替代进程受阻，则可能面临业绩增速放缓的风险；

(3) 行业竞争加剧：目前在集成电路、被动元器件等领域，国内上市企业以生产中低端产品为主，高端领域国产替代空间较大。若上市企业进行大量产能扩张，则行业未来可能面临产能过剩的局面，带来竞争加剧的风险。

东莞证券研究报告评级体系：

公司投资评级	
买入	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 15%以上
增持	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 5%-15%之间
持有	预计未来 6 个月内，股价表现介于市场指数±5%之间
减持	预计未来 6 个月内，股价表现弱于市场指数 5%以上
无评级	因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，导致无法给出明确的投资评级；股票不在常规研究覆盖范围之内
行业投资评级	
超配	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 10%以上
标配	预计未来 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±10%之间
低配	预计未来 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

说明：本评级体系的“市场指数”，A 股参照标的为沪深 300 指数；新三板参照标的为三板成指。

证券研究报告风险等级及适当性匹配关系	
低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	主板股票及基金、可转债等方面的研究报告，市场策略研究报告
中高风险	创业板、科创板、北京证券交易所、新三板（含退市整理期）等板块的股票、基金、可转债等方面的研究报告，港股股票、基金研究报告以及非上市公司的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

投资者与证券研究报告的适当性匹配关系：“保守型”投资者仅适合使用“低风险”级别的研报，“谨慎型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中低风险”的研报，“稳健型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中风险”的研报，“积极型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中高风险”的研报，“激进型”投资者适合使用我司各类风险级别的研报。

证券分析师承诺：

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰地反映了本人的研究观点，不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系，没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益，或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

声明：

东莞证券股份有限公司为全国综合性综合类证券公司，具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下，本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有，未经本公司事先书面许可，任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发，需注明本报告的机构来源、作者和发布日期，并提示使用本报告的风险，不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的，应当承担相应的法律责任。

东莞证券股份有限公司研究所

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码：523000

电话：（0769）22115843

网址：www.dgza.com.cn